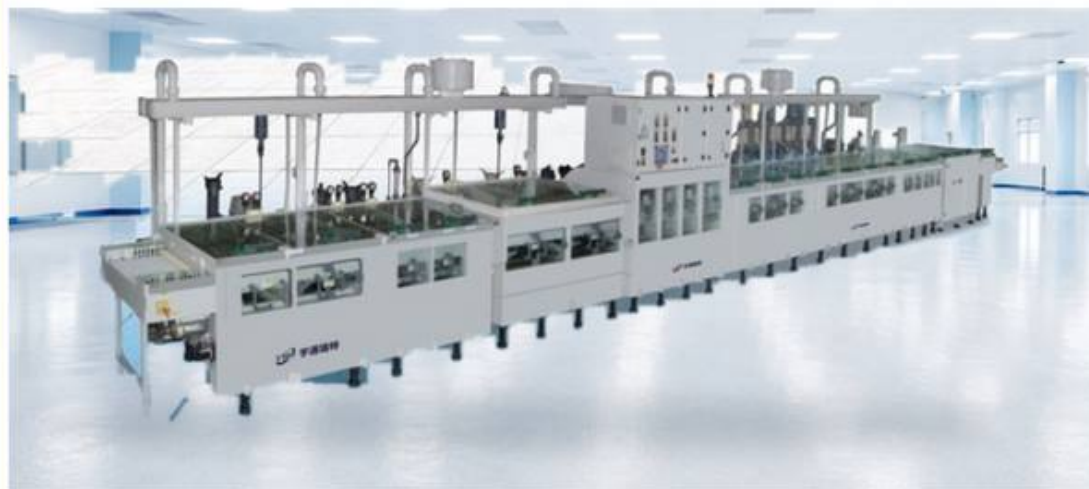


ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Горизонтальные и вертикальные линии мокрых процессов
для PCB, FPCB, керамических подложек и полупроводников.



НАДЁЖНОСТЬ

Стабильные процессы

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Интеграция с MES

СЕРВИС

Поддержка и обучение

УДАЛЕНИЕ ЗАУСЕНЦЕВ И ОЧИСТКА



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ультразвуковая мойка очищает стенки отверстий.
- Заднее расположение сливных труб упрощает обслуживание.
- Качающаяся высоконапорная промывка удаляет пыль и медь.
- Совместима с ленточной и тяжёлой шлифовкой.
- Интеграция с MES.

НАЗНАЧЕНИЕ

Удаление заусенцев, пыли стеклотекстолита и меди после сверления.

ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ



ДЕСМИР И ХИМИЧЕСКАЯ МЕТАЛЛИЗАЦИЯ (PTH)

08



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Водяной нож с разделением потока.
- Шестерни SUS316 для высокотемпературных секций.
- Электромагнитный расходомер стабилизирует подачу.
- Регенерация перманганатного раствора.
- Циркуляция предотвращает кристаллизацию.

НАЗНАЧЕНИЕ

Подготовка стенок отверстий и формирование первичного проводящего слоя.

ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

